

中国硅酸盐学会

中硅字(2023)第 27 号

第 13 届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛三轮通知

为了促进学科发展，充分发挥中国硅酸盐学会的学术交流优势和《硅酸盐学报》、*Journal of Materiomics*、*InfoMat*（均为“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊）、*InfoScience*作为开展学术交流、学术争鸣重要园地的作用，第13届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛将于2023年8月25日~8月27日在四川省成都市举办。该研讨会和论坛由中国硅酸盐学会主办，电子科技大学电子薄膜与集成器件全国重点实验室和物理学院承办。

一、研讨主题

先进土木工程材料、先进功能陶瓷材料、先进结构材料、超导材料与器件、光电信息材料与器件、新型二维材料与器件、先进能源材料、先进催化材料、先进表征与装置。

二、会议时间及地点

1、报到时间及地点：

8月25日 10:00~20:00，成都新希望高新皇冠假日酒店。

2、会议日期及地点：

8月26日 8:30~18:00，8月27日 8:30~17:00，成都新希望高新皇冠假日酒店。

3. 会议住宿：

成都新希望高新皇冠假日酒店、成都新希望高新中心假日酒店（四川成都郫都区西芯大道1号）。

三、会议组织

大会主席：高瑞平（中国硅酸盐学会理事长）

南策文（中国硅酸盐学会副理事长，中国科学院院士，清华大学教授）

李言荣（西北工业大学党委书记，中国工程院院士）

执行主席：晋占平（中国硅酸盐学会副理事长）

熊 杰（电子科技大学物理学院院长）

四、会议注册

1、网络注册

请登录以下网址 <https://inmc13.ceramsoc.com/>或扫描二维码进行会议注册、提交摘要和缴费。



请扫描中国硅酸盐学会会员之家
小程序报名参会

2、注册费

2023年7月31日(含7月31日)前支付，2200元/人(在校学生1200元/人)；

2023年8月1日后或现场支付，2500元/人(在校学生1500元/人)。

在注册网站缴费或将注册费汇至下列账户

户名：中国硅酸盐学会

开户银行：中国工商银行北京百万庄支行

账号：0200001409014435189

汇款时请注意：

- 注明：第13届研讨会注册费和参会者姓名；如为学生请注明；
- 请将汇款凭证的截图或照片，开票信息发送给 jccs@ceramsoc.com,

邮件标题命名为“参会者姓名-会议费”，以便于开具发票。

- 请到现场报到时携带汇款凭证的截图或照片。

五、会议日程

活动内容	日期	时间
注册签到	8月25日	10:00~20:00
大会开幕式	8月26日	08:30~09:00
大会报告	8月26日	09:00~12:30
分会场报告	8月26日	13:30~18:00
	8月27日	08:30~12:00
	8月27日	13:30~17:30
无机非金属材料学科优秀学者“自立自强”论坛	8月27日	08:30~12:00
	8月27日	13:00~17:30

六、会议食宿

1、酒店预订

请扫描以下二维码预订酒店。预订咨询：郭兰英 13678037442
(fran.guo@cpcdwest.com)。



成都新希望高新皇冠假日酒店



成都新希望高新中心假日酒店

2、会议期间食宿费用自理。

七、会议联系

中国硅酸盐学会：

周立忠(13522585433, zhoulizhong2010@163.com)

张津溥(13671252214, zhangjinpu@gsyxb.wecom.work)

电子科技大学：

晏超贻(18780138749, inorgmat@uestc.edu.cn)

八、展览展示联系

中国硅酸盐学会：

张津溥(13671252214, zhangjinpu@gsyxb.wecom.work)

电子科技大学：

晏超贻(18780138749, inorgmat@uestc.edu.cn)

